



26. September 2005

### **Angebot**

#### **CR 88**

#### **bleifreie „NO-CLEAN“ - SMD – Lotpaste**

Die Lotpaste CR 88 ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle SMD-Anwendungen bestens geeignet ist. Aufgrund von dieser Lotpaste wurde eine bleifreie SMD – Lotpaste entwickelt, die sowohl den sorgfältigen Richtlinien der verschiedenen Normen entspricht als auch einer guten Verarbeitung im Reparaturfall geeignet ist. Die Flußmittelzusammensetzung entspricht FSW 32. Die Lotlegierung selbst ist wie folgt zusammen gesetzt: Sn96,5Ag3,5

#### Qualifikation:

Die Lotpaste CR 88 ist eine RMA-Paste, die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Die entsprechenden Korrosions-, Lotkugel- und Benetzungstest wurden ebenso wie die Konturenstabilitätsprüfung (SN 59650) bestanden.

Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfrei der FSW 32 entsprechende Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können.

#### Lagerung:

Das ungeöffnete Gebinde sollte bei einer Lagerung von 20°C Raumtemperatur gelagert werden. Im geöffneten Zustand ist die maximale Verarbeitungszeit von den Umwelteinflüssen abhängig.

#### Verbrauchshinweise:

Nach der Entnahme der Paste muß die Spritze wieder möglichst dicht verschlossen werden. Benutzte Paste sollte nicht mit der frischen zusammen in einem Behälter aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozeß können diese selbstverständlich zusammen verwendet werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen dürfen allerdings nicht vermischt werden.

#### Vorteile:

- \* NO CLEAN - Paste
- \* hervorragende Konturenstabilität
- \* keine Lotkugel- oder Spritzerbildung
- \* langzeitige Verarbeitung und lange Lagerzeit möglich
- \* hervorragend geeignet für „fine-pitch“-Anwendungen
- \* einwandfreie Lötresultate beim Einsatz mit Heißluft und LötKolben